

第十四届电接触材料技术交流会通知

各相关单位：

电接触材料及元件作为各类高低压开关的核心部件，其性能的优劣直接决定了整个电器产品的通断容量、使用寿命和运行可靠性等，是现代国民经济和社会发展的重要支撑材料之一。鉴于电接触材料及元件对整个电器产品运行所产生的深远影响，深入开展电接触材料的研究已成为切实保障电器产品稳定运行的关键途径，电接触材料领域的技术交流与进步尤为关键。

在此契机下，由桂林电器科学研究院有限公司主办，温州宏丰电工合金股份有限公司承办的“第十四届电接触材料技术交流会”定于 2025 年 11 月 19-21 日在浙江温州市召开。

一、主题报告

1. 自超滑材料的鲁棒滑动电接触研究——清华大学
2. 纳米氧化铜修饰偏锡酸锌增强银基复合材料力电性能调控研究——浙江大学
3. 电器触头电弧运动仿真及其性能评估方法——河北工业大学
4. 新型银基触点材料的设计及电弧侵蚀机理研究——西安工程大学
5. 环保新型 Ag/MAX 电接触材料的研究进展与挑战——安徽工业大学
6. 人工智能赋能智能化检测、运维与优化——以电器元件工厂为例——杭州电子科技大学
7. 面向复杂工况功能复合材料及连接技术性能研究——温州宏丰电工合金股份有限公司
8. 塑封继电器用银金属氧化物 (AgMeO) 触点材料失效机理的研究与开发——桂林金格电工电子材料科技有限公司
9. 频繁投切断路器增强基/铜钨触头材料研制与服役评估关键技术——广西电网有限责任公司电力科学研究院
10. 高导无氧碲铜合金在高压直流接触器的应用——四川科派新材料有限公司

二、会议时间

2025年11月19日报到，20日会议，21日疏散。

三、会议地点

浙江省温州市温州大学城开元名庭酒店（温州市瓯海区茶山街道梅泉大街586号温州大学科技综合大楼2号）。

四、费用

会议费2000元/人。食宿统一安排，住宿费用自理。会议费提前转账，发票可会前开具。现场缴费，发票会后开具。会议费银行转账信息（户名：桂林电器科学研究院有限公司；开户行：交通银行北京海淀支行；账号：01010001934010100328）。

五、报名方式及住宿

请各位参会代表于11月15日前通过扫描下方二维码填写回执。会议临时新建微信群，请回执缴费后联系会务人员进群。



会议推荐入住温州大学城开元名庭酒店。会议期间住宿紧张，请参会人员提前联系酒店自行预定房间，享受协议价338元/（间·天）。酒店联系人：王静，手机号码：17328810099。

六、会务联系

赵浩融 18977305733；崔得锋 18107839282；黄岚霞 13557337250；黄健 15078368227

桂林电器科学研究院有限公司

二〇二五年十月二十日

